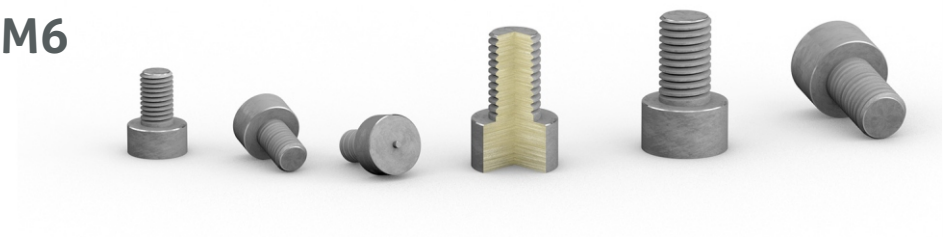
MTCON NECTIVITY

POWER TOWER M6

AUSSENGEWINDE,
SMD LÖTTECHNIK,
OHNE ZENTRIERZAPFEN



KAUFMÄNNISCHE DATEN

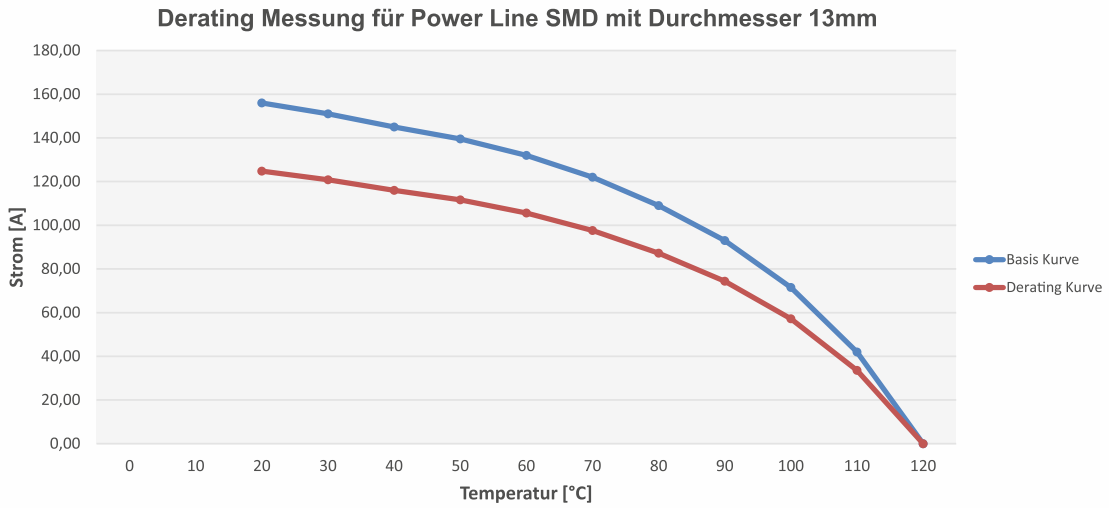
Artikelnummer	01.6.0004

Verpackungseinheit tape and reel - 1.6.0004.GU	180 Stück
Zolltarifnummer	85369010
Gewicht	8,57 g
Herkunftsland	DE (Deutschland)

TECHNISCHE DATEN

Strombelastbarkeit	ca. 180 A bei 20°C / ca. 100 A bei 85° C
Material	CuZn39Pb3
Oberfläche	matt verzinnt

Deratingkurven basieren auf einer Momentaufnahme unter Testbedingungen!
Getestet wurde mit einer 2-lagigen Leiterplatte, 70µm Endkupfer.



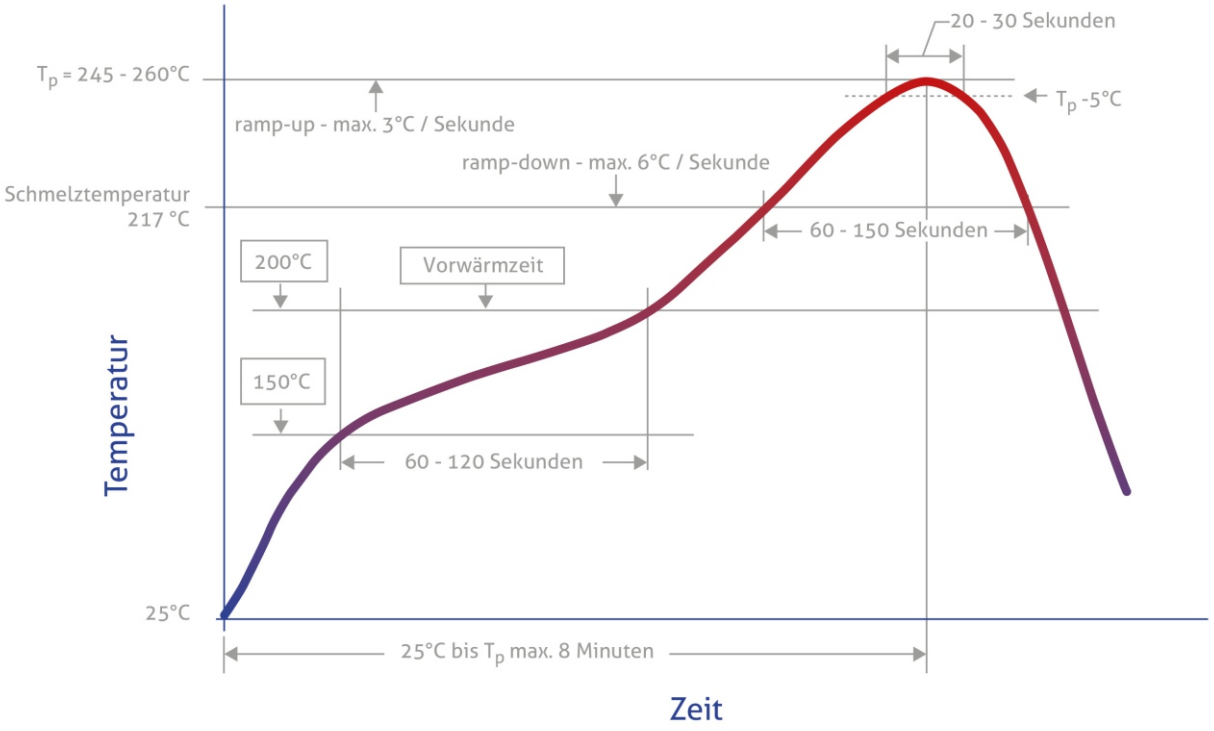
Rev. 201801

MTCONNECTIVITY

VERARBEITUNG

Drehmoment	**3,9 Nm**
Lötpastendicke	**150 µm**
Betriebstemperatur	**-55°C bis 150°C**

LÖTPROFIL



Reflow Temperatur in Abhängigkeit der Leiterplattendicke:

Eigenschaften	Volumen mm³ <350	Volumen mm³ 350-2000	Volumen mm³ >2000
Leiterplattendicke (Bleifrei) < 1.6 mm	260 °C	260 °C	260 °C
Leiterplattendicke (Bleifrei) 1.6 mm - 2.5 mm	260 °C	250 °C	245 °C
Leiterplattendicke (Bleifrei) ≥ 2.5 mm	250 °C	245 °C	245 °C

mit Bezug auf IPC/JEDEC J-STD-020D

KONFORMITÄT

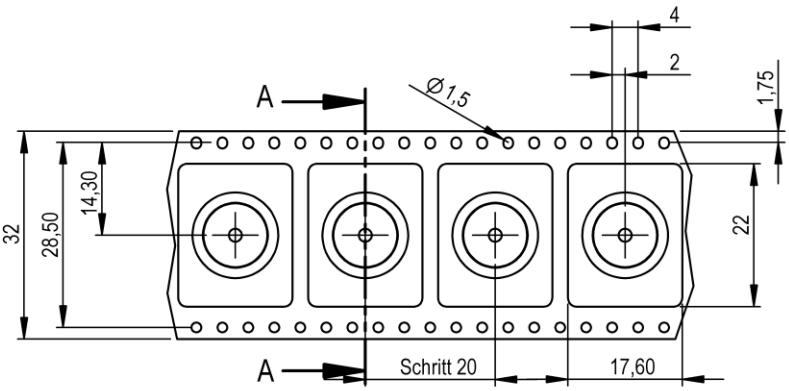
- RoHS konform
- REACH konform

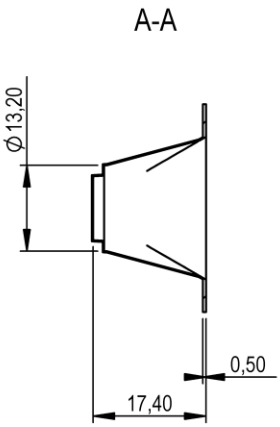
RoHS COMPLIANT

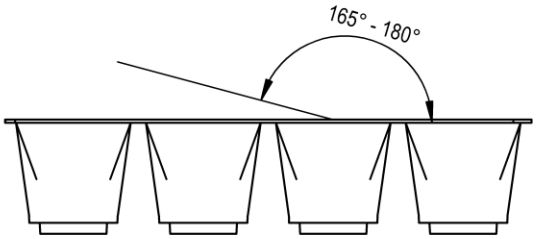
REACH COMPLIANT

Rev. 201801

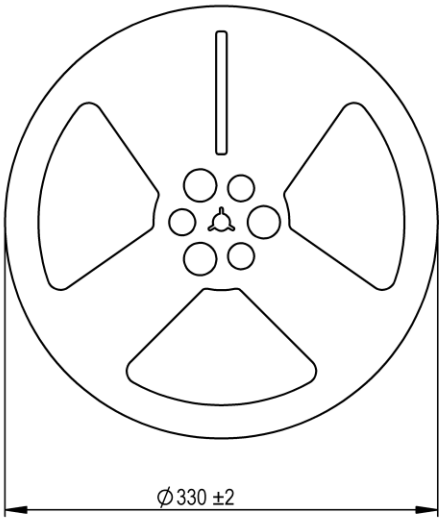
TAPE AND REEL

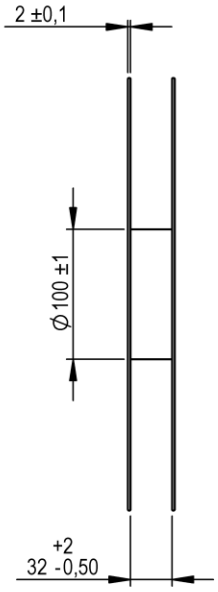




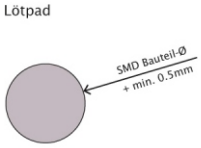


Packaging according IEC 60286-3:2007
Tape-Breite / tape width: 32 mm
pull-out-force: 0,1 N - 1,3 N
no components in the first min. 100mm
no components in the last min. 160mm





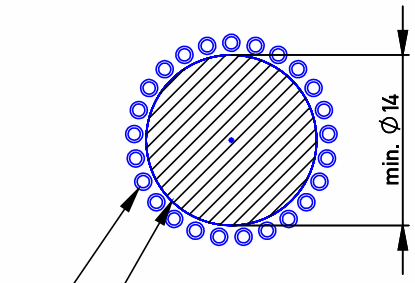
LAYOUT



MTCONNECTIVITY

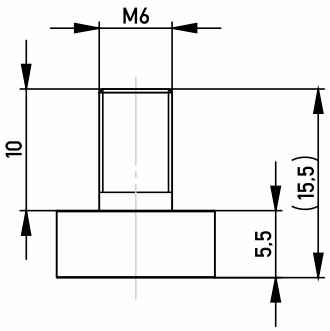
LAYOUT

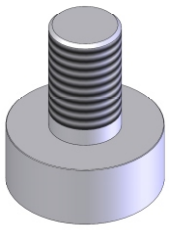
Verpackung / *packaging*	Artikelnummer / *part number*
lose / *bulk*	01.6.0004
tape and reel	01.6.0004.GU

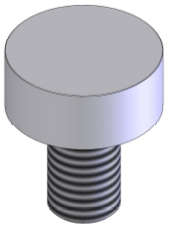


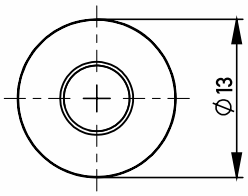
Empfehlung Lötpad / *recommendation solder pad*
vollflächiges Pad min. 0.5mm umlaufend größer als Element /
full-face pad all round min. 0.5mm bigger than the element

optionale DK-Bohrungen umlaufend um das Pad - für höhere Stromtragfähigkeit /
optional plated holes around the pad - for higher current ratings









RoHS COMPLIANT

Ausführung: SMD
Max. Drehmoment: 3,9 Nm
Gewicht: 8,57 g
Technische Änderungen vorbehalten

execution: SMD
max. torque: 3,9 Nm
weight: 8,57 g
technical subject to change

Werkstoff / *material*	CuZn39Pb3
Oberfläche / *surface plating*	matt verzinnt / *mat tin-plated*
Prozessbedingte Fehlstellen in Galvanik möglich! *imperfections during electro plating process possible!*	

Toleranz / *tolerance*: DIN ISO 2768-mH

all dimensions in mm

Maßstab / *scale*: 2:1

Zeichnungsnummer / *drawing number*: 01.6.0004

	Datum / *date*	Name / *name*
Bearb. / *drawer*	13.02.2014	
gepr. / *auth.*		
geän. / *mod.*		

Benennung / description

Power Tower M6
SMD, 13er rund, ohne Zentrierzapfen

Index	Änderung / *modification*	Datum / *date*	Name / *name*
	REACH entfernen	17.07.2018	
A	Neuerstellung	13.02.2014	

MTCONNECTIVITY
power2pcb GmbH
Hauptstraße 18
74676 Niedernhall
GERMANY

Vertraulich! Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe oder Vervielfältigung ohne vorherige schriftliche Zustimmung verboten.
Confidential! All rights reserved. Forwarding or duplication without previous written permission prohibited.

K
A4